

Peningkatan kualitas produk PCB menggunakan metode process attribute chart, defect analysis matrix, dan fault tree analysis = Quality improvement of PCB product using process attribute chart defect analysis matrix and fault tree analysis methods

Irma Anggraeni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20350266&lokasi=lokal>

Abstrak

Defect yang terjadi berulang pada sebuah produk menandakan bahwa penyebab utama defect tersebut belum ditemukan, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar penyebab terjadinya defect pada proses perakitan PCB. Untuk mengetahui akar penyebab permasalahan tersebut, digunakanlah metode Fault Tree Analysis, didukung dengan metode Process Attribute Chart dan Defect Analysis Matrix untuk mengarahkan fokus penelitian.

Penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya defect berasal dari peralatan atau Jig yang digunakan serta pengaturan parameter mesin yang tidak sesuai. Metode Fault Tree Analysis dapat menunjukkan prioritas perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah defect serta meningkatkan kualitas produk.

.....Defects that occur repeatedly on a product indicates that the main cause of the defect has not been found, it can affect the quality of product. This study aims to determine the root cause of the defect in the assembly process of PCB. To find the root cause, Fault Tree Analysis method is used, supported by Process Attribute Chart and Defect Analysis Matrix methods to direct the focus of research.

Research shows that the main cause of the defect are from the tools that used in process and machine parameter settings are not appropriate. Fault Tree Analysis method can indicate the priority improvements made to reduce the number of defects and improve quality of product.